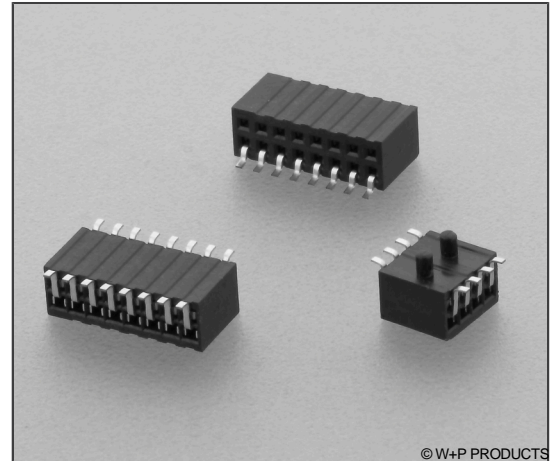


SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, seitlich steckbar, 2-reihig SMT Female Headers, 1.27mm Pitch, Side Entry, Double Row

Technische Daten / Technical Data

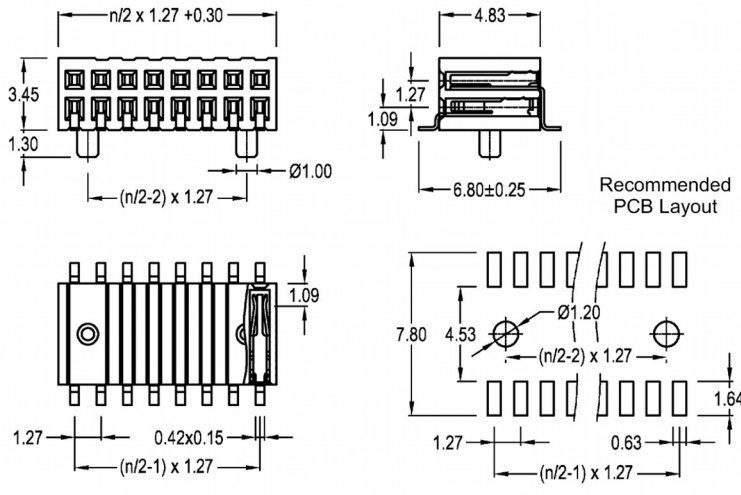
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Phosphorbronze <i>Phosphor bronze</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

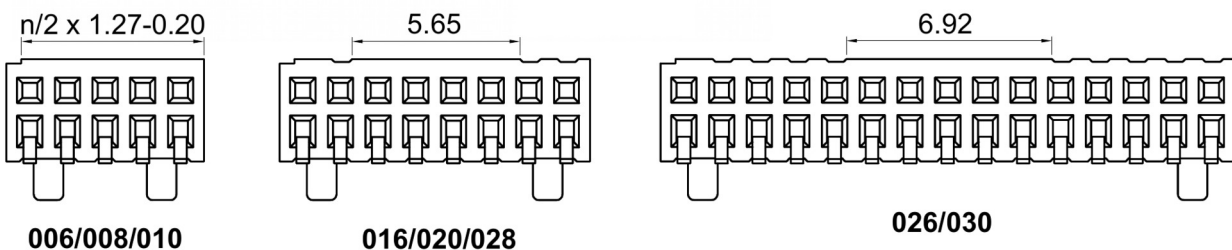
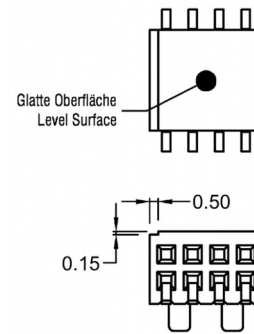
Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,40mm.
Dual beam contacts accept 0.40mm square pins.

ST/FTR-Optionen ST/FTR Options



TR-Option für folgende Polzahlen Pick and Place Areas for No. of contacts

006/008/010/016/020/026/028/030



Series	Contacts*	Plating*	Locating Pegs*	Packing*
7130	026 006/008/010/016/ 020/026/028/030 Film-Pad nicht erforderlich. <i>Film pad not necessary</i>	00 00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Sel. Au/Sn</i>	00 00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i> 10 Mit Pos.hilfen <i>With loc. pegs</i>	TR TR Tape & Reel, ISK mit Ansaugfläche <i>Tape & Reel, Ins. with Pick&Place Area</i> ST In Stangen <i>In tubes</i>
	012/014/018/022/ 024/032-080 Optionen FTR oder ST <i>Options FTR or ST</i>			FTR Tape & Reel mit Film Pad <i>Tape & Reel with Film Pad</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

